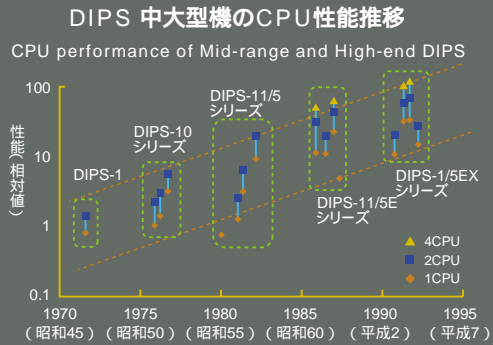
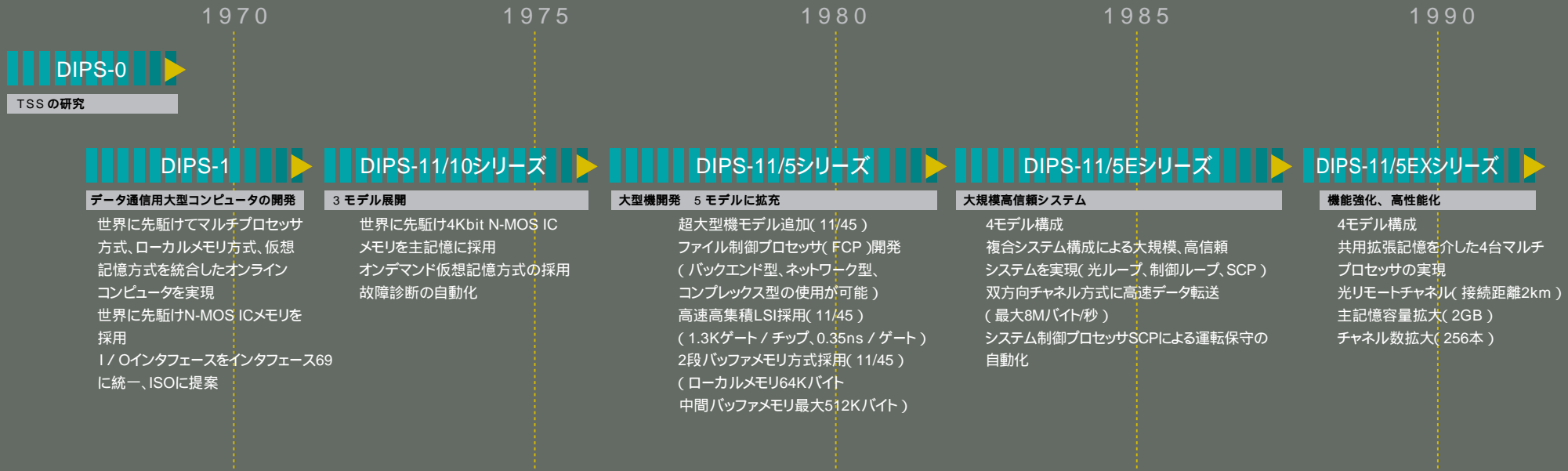
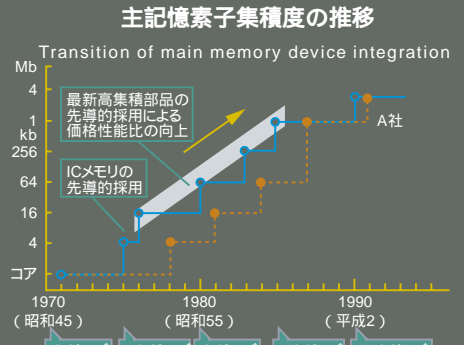


DIPS 本体系技術開発の系譜

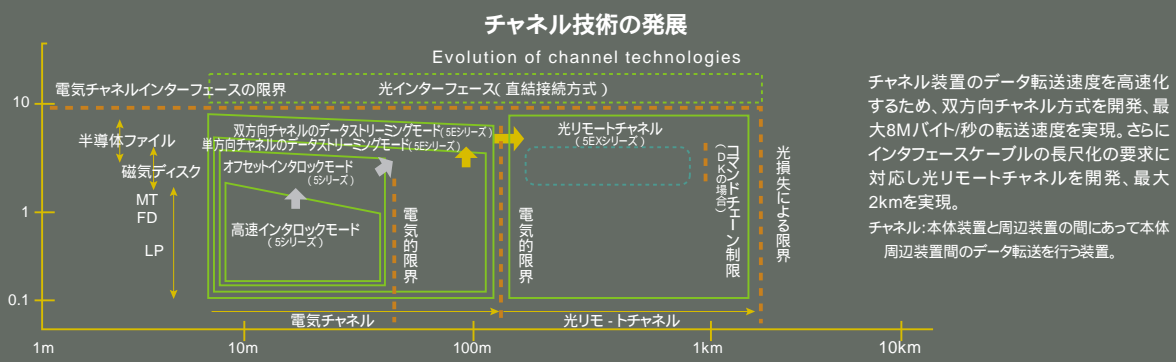
Development history of DIPS mainframe system technologies



最新の部品技術の採用と方式技術の開発により、プロセッサ性能は10年で8倍～10倍の割合で向上。



LSIメモリ素子の進歩をいち早く取り込み、価格性能比を向上。



チャンネル装置のデータ転送速度を高速化するため、双方向チャンネル方式を開発、最大8Mバイト/秒の転送速度を実現。さらにインタフェースケーブルの長尺化の要求に対応し光リモートチャンネルを開発、最大2kmを実現。
チャンネル:本体装置と周辺装置の間において本体周辺装置間のデータ転送を行う装置。